

Specification No.

SA-1118S-Z0-1/5

御中

製品仕様書
Product specifications

製品名 Product Name	φ 1.8 PCピン φ 1.8 pc pin
製品番号 Number	812122-2MA

受領印欄
Acknowledged

4					承認 Approved	確認 Checked	作成 Prepared
3					小泉	根本	村上
2							
1							
Issue No.	2018.12.14 日付 Date	変更内容 Revision	変更 Change	承認 Approved			

仕 様 書 Specifications

SA-1118S-Z0-2/5

1. 適用範囲 (Scope)

この製品仕様書は「 $\phi 1.8$ P C ピン」の一般仕様及び性能について規定する。
The present document concerns general specifications and performances of " $\phi 1.8$ pc pin".

2. 製品名・製品番号 (Product name and number)

製品名 Product Name	製品番号 Number	材料及び表面処理 Material and surface treatment
$\phi 1.8$ P C ピン $\phi 1.8$ pc pin	8 1 2 1 2 2 - 2 MA	黄銅 スズメッキ材 Brass, pre-tin plated

3. 形状・寸法・材料 (Geometry and materials)

添付図面による。
Refer to attached drawings.

図面番号 Drawing No.	製品名 Product name	記号 Mark
J C - 0 2 1 2 - 0 2	$\phi 1.8$ P C ピン $\phi 1.8$ pc pin	0

4. 定格 (Rated values)

項目 Item	規格値 Description
適用電線範囲 (注1) Wire size (Note 1)	AWG # 2 0 ~ # 2 6 最大被覆外径 $\phi 1.8$ mm AWG #20 to #26 Maximum diameter of insulation covering $\phi 1.8$ mm
適用プリント基板 Applicable P.C. board	厚さ: 1.57 ± 0.2 mm 穴径: $\phi 1.8^{+0.1}_{-0}$ mm Thickness 1.57 ± 0.2 mm Hole diameter $\phi 1.8^{+0.1}_{-0}$ mm

(注1) 電線はより線を使用し、単線等の特殊電線は原則として使用出来ません。
(Note 1) Use a stranded wire. Do not use solid or other special wires.

5. 性能 (Performances)

5-1 外観 (Appearance)

No.	項目 Item	規格値 Description	条件 Check
5-1-1	外観 Appearance	使用上有害となる様な割れ・変形等が無いこと Crack, deformation, etc. harmful in use are not allowed	目視 Visual

5-2 機械的性能 (Mechanical properties)

No.	項目 Item	規格値 Description		試験条件及び方法 Check
5-2-1	圧着部引張強度 Tensile strength of crimped section	電線 Wire size	強度 N 以上 Minimum strength in N	ターミナルのワイヤバレルと電線導体を圧着し、治具で固定し電線の軸方向に引っ張る。 試験速度 25 mm/min Crimp the terminal's wire barrel and conductor together, fasten the altogether, and pull the wire axially at 25 mm/min
		AWG#20	78.4	
		AWG#22	39.2	
		AWG#24	29.4	
		AWG#26	19.6	
5-2-2	プリント基板への挿入力 Insertion force to P.C. board	29.4 N 以下 29.4 N or less		ターミナルを基板に挿入するのに要する力を万能試験機を用いて測定する。 試験速度 25 mm/min Using universal testing machine, measure the force required for inserting the terminal into board at 25 mm/min
5-2-3	プリント基板との保持力 Pull-out force to P.C. board	3.92 N 以上 3.92 N or more		基板に装着したターミナルを軸方向に引っ張り、基板からターミナルが離脱するときの荷重を万能試験機を用いて測定する。 試験速度 25 mm/min Using universal testing machine, pull the terminal axially at 25 mm/min until it leaves the board. Take the reading at this point.

5-3 電氣的性能 (Electrical characteristics)

No.	項目 Item	規格値 Description	試験条件及び方法 Check
5-3-1	接触抵抗 Contact resistance	初期 5 mΩ 以下 5 mΩ or less initially	圧着後、電気抵抗を測定し、電線抵抗を差し引いて接触抵抗とする。 試験電流 15 mA以下 (20 mV 以下) After crimping, measure the overall resistance at 15mA or less and 20mV or less, from the reading, subtract the wire resistance. Retain the difference as contact resistance.
5-3-2	耐電圧 Dielectric strength	AC 1000 V / 1 分間 異常なきこと Shall remain normal	ハウジング外面とコンタクト相互間及び隣接するコンタクト間にて測定する。 Apply 1000 V AC for 1 min between connector housing and each of contacts, and between adjacent contacts

5-4 耐久環境性能 (Durability)

No.	項目 Item	規格値 Description	試験条件及び方法 Check
5-4-1	耐塩水噴霧性 Salt mist	外観 Appearance	基板装着後、下記条件に放置 温度 35 ± 2℃ 塩水濃度 5 ± 1% (重量比) 噴霧時間 48 ± 4 時間 接触抵抗測定は、水洗をし室温で乾燥させてから、1 ~ 2 時間放置後測定。 After it installs in the substrate, and keep the sample under following conditions. Temperature 35 ± 2°C. Salt concentration 5 ± 1%wt. Spray time 48 ± 4 h. Then, rinse the sample, and leave it dry at room temperature for 1 to 2 h.

No.	項目 Item	規格値 Description		試験条件及び方法 Check
5-4-2	耐硫化水素 ガス性 Hydrogen sulfide	接触抵抗 Contact resistance	10 mΩ 以下 10 mΩ or less	基板装着後、下記硫化水素ガス中に放置。 濃度 50 ± 5 ppm 温度 40 ± 2°C 放置時間 24 ⁺⁴ ₋₀ 時間 室内で1～2時間放置後測定。 After it installs in the substrate, and keep it in hydrogen sulfide for 24 ⁺⁴ ₋₀ h. Density 50 ± 5 ppm. Temperature 40 ± 2°C. Leave the sample at the room for 1 to 2 h before check.
5-4-3	耐アンモニア性 Ammonia	接触抵抗 Contact resistance	10 mΩ 以下 10 mΩ or less	基板装着後、下記アンモニア水の入ったデシケータ容器中に放置 濃度 28% 温度 25 ± 2°C 容積比 25 ml / ℓ 放置時間 40分 室内で1～2時間放置後測定。 After it installs in the substrate, and keep it in desiccator filled with following aqueous ammonia for 40 min. Concentration 28%. Temperature 25 ± 2 °C. Volume ratio 25 m ℓ / ℓ Leave the sample at the room for 1 to 2 h before check.
		外観 Appearance	異常なきこと Shall remain normal	

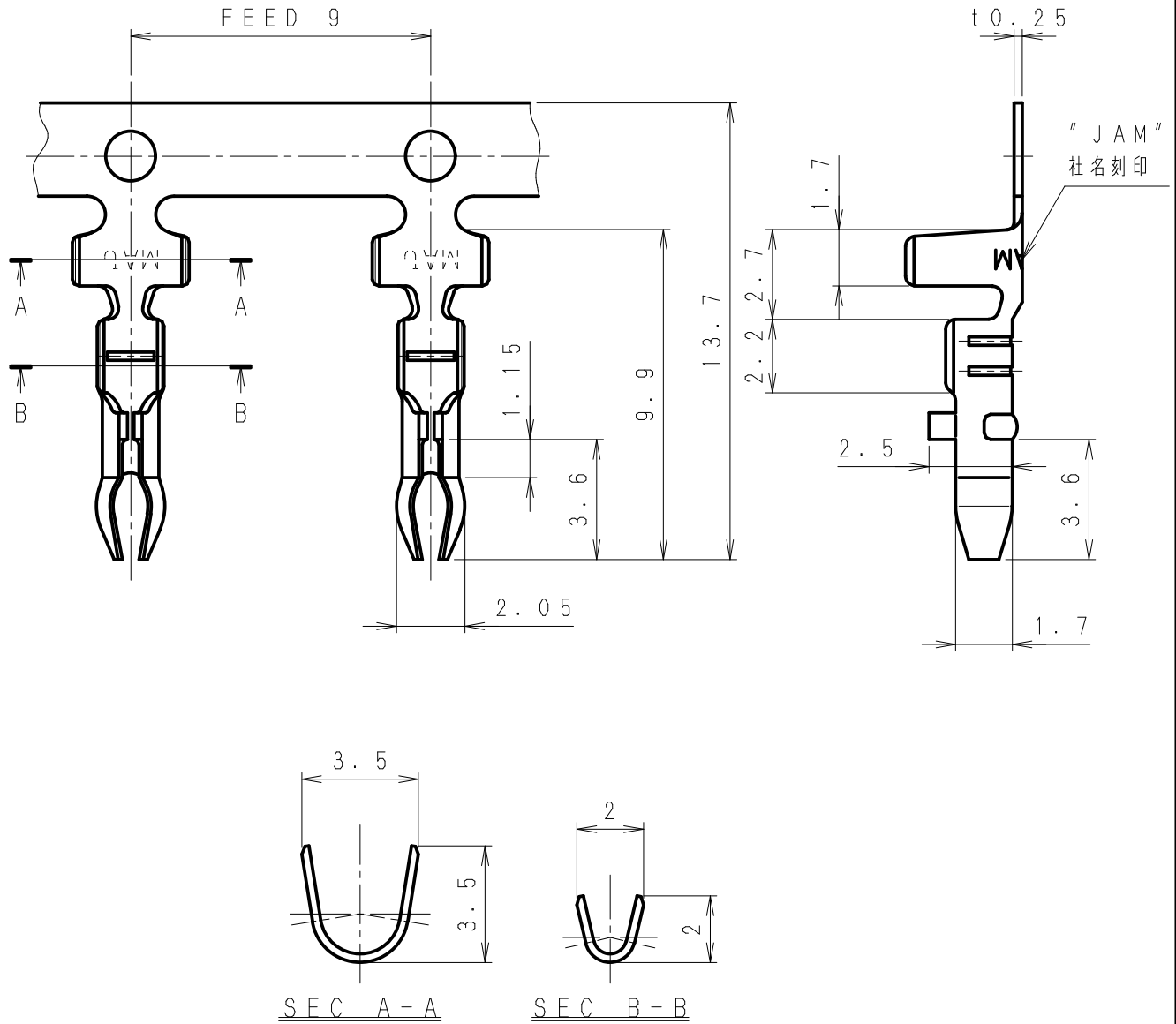
5-5 半田付性能 (Soldering characteristics)

No.	項目 Item	規格値 Description	試験条件及び方法 Check
5-5-1	はんだ付性 Solderability	半田面に半田がムラ無く 全体に付くこと 浸漬面積の90%以上 90% or more of dipped solder side shall be coated uniformly with solder	はんだ付部をフラックスに5～10 秒浸漬後、下記条件のはんだ槽に浸 漬する。 はんだ槽温度 245 ± 5°C 浸漬時間 3 ± 0.5秒 Dip the soldering section into flux for 5 to 10 sec, and then into solder tank of 245 ± 5°C for 3 ± 0.5 sec.

第三角法
3rd ANGLE PROJECTION

単位: mm
UNIT: mm
注) 図面を実測しないこと
NOTES) DO NOT SCALE

図番 DRAWING No.
JC-0212-02



⑤	. .								
④	. .				812122-2MA	黄銅 Brass	錫鍍金材 Pre-tin Plated	AWG#20~#26	MAX φ1.8
③	. .								
②	. .				製品番号 PRODUCT NO.	材 料 MATERIAL	表面処理 FINISH	適用電線 WIRE SIZE	被覆外径 INSULATION DIA
①	. .								
記号 No.	年月日 DATE	変更記事 REVISION RECORD	設計 DESIGN	承認 APP	製品名 NAME		φ1.8 PCピン φ1.8 pc pin		
承認 APPROVED	確認 CHECKED		一般公差 TOLERANCE		尺度 SCALE	図番 DRAWING No.			
K. Koizumi	N. Nemoto		±0.3		5 / 1	JC-0212-02			
設計 DESIGN		製図 DRAWING							
T. Murakami		T. Murakami							